



AT&S

WIENER PRIVATBANK

DR. PETER SCHNEIDER

13. NOVEMBER 2023



AT&S AUF EINEN BLICK

Weltweit führend bei High-End-Leiterplatten und ABF-Substraten

~14,000

Mitarbeiter

#2

Hersteller von High-End-Leiterplatten weltweit ⁽¹⁾

€ 1,8 Mrd.

Umsatz im GJ 22/23

~700

Aktive Patente

#5

Hersteller von ABF-Substraten weltweit ⁽¹⁾

13% Wachstum

bei Umsatz im GJ 22/23

Leoben, AUT

Headquarter

6 + 1 ⁽²⁾

Produktionsstandorte in Europa & Asien

€ 417 Mio.

EBITDA in GJ 22/23
Marge von 23,0%

1987

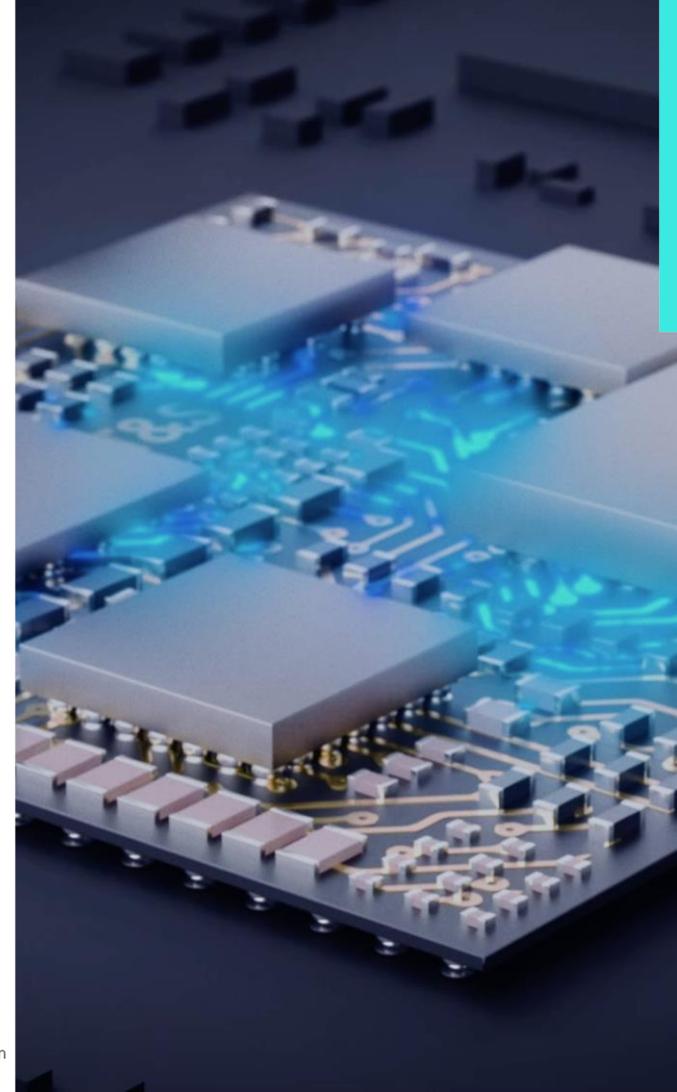
Gründungsjahr

36%

Vitality index ⁽³⁾

€ 1,1 Mrd.

Marktkapitalisierung
Börse Wien ⁽⁴⁾



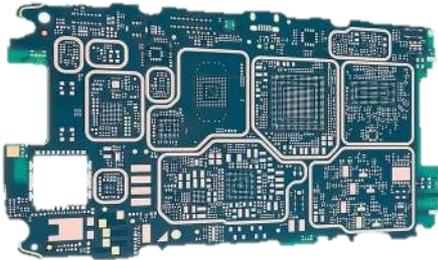
1. Prismark, basierend auf Umsätzen aus 2022
2. Im Bau befindlich

3. Umsatzanteil technologisch innovativer Produkte, die in den letzten drei Jahren eingeführt wurden
4. Stand: 8. November 2023

HIGH-END TECHNOLOGIEN ...

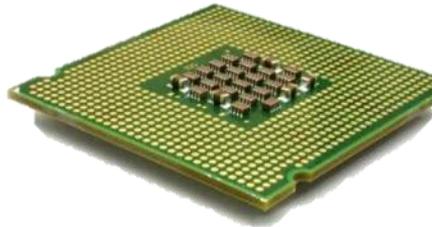
Lösungen von AT&S ermöglichen fortschrittlichste elektronische Anwendungen und Technologien

High-End Leiterplatten



- Für komplexeste, dichteste und leistungsfähigste Systeme ausgelegte Leiterplatten
- Hauseigene Technologien ermöglichen höhere Schaltdichten, besseres elektrisches Verhalten und bessere Signalübertragung

ABF Substrate



- ABF Substrate für die Flip-Chip-Technologie
- Packaging hochleistungsfähiger integrierter Schaltkreise für multiple Anwendungen wird ermöglicht
- Beste Balance zwischen Leistung, Zuverlässigkeit und Werthaltigkeit durch hochautomatisierten, kontaktlosen Aufbauprozess

Substrate für Module



- Umfassende Lösungen für Module, inklusive Integrationsdienstleistungen wie Co-Design, Simulation, Architekturoptimierung sowie Assembly- und Test-Services

ÖSTERREICHISCHES UNTERNEHMEN MIT GLOBALER PRODUKTION



Leoben, Zentrale & Werk
Österreich
1.568⁽¹⁾



Fehring
Österreich
415⁽¹⁾



Nanjangud
Indien
1.351⁽¹⁾



Chongqing
China
6.912⁽¹⁾



Shanghai
China
4.017⁽¹⁾



Ansan
Korea
336⁽¹⁾



Kulim
Malaysia
Produktionsstart 2024

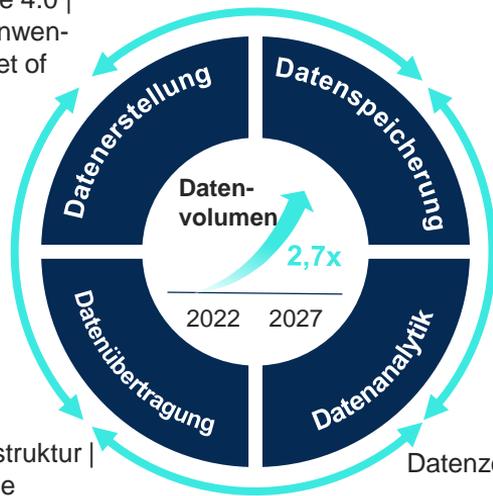
ENTSCHEIDENDE MEGATRENDS FÜR AT&S

Digitalisierung & Elektrifizierung mit Fokus auf Effizienz

In der Digitalisierung ...

Unterhaltungselektronik |
ADAS | Industrie 4.0 |
Medizinische Anwendungen | Internet of Things | ...

HDDs | DRAMs |
NANDs



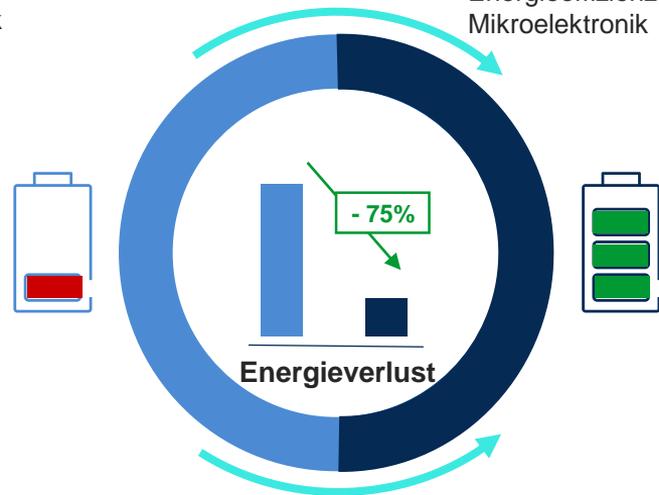
Drahtlose Infrastruktur |
Drahtgebundene
Infrastruktur | Satelliten

Datenzentren | Server
| Big Data | In-
Memory Computing

In der Elektrifizierung ...

Energieeffizienz **ohne** Mikro-
elektronik

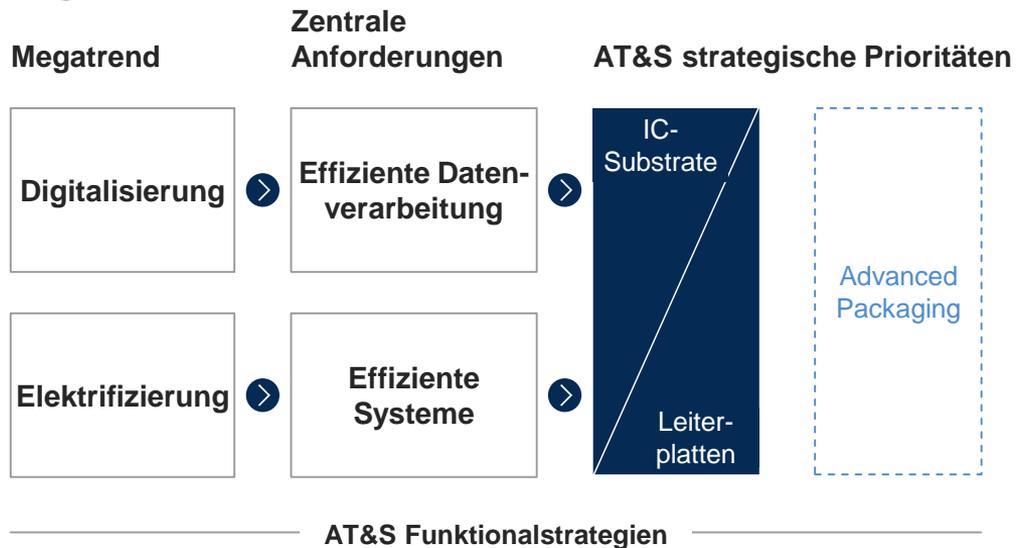
Energieeffizienz **mit**
Mikroelektronik



Starke Auswirkung der Mikroelektronik auf Reduktion von Emissionen und Energieverlust entlang aller Elektrifizierungsanwendungen

„MORE THAN AT&S“

Wir sind für Partnerschaften mit unseren Kunden gut aufgestellt

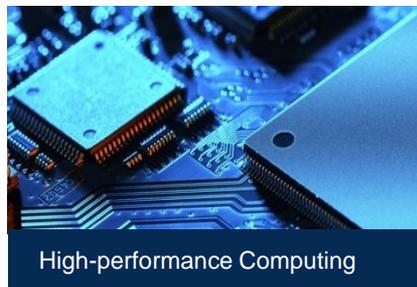


AT&S BUSINESS UNITS

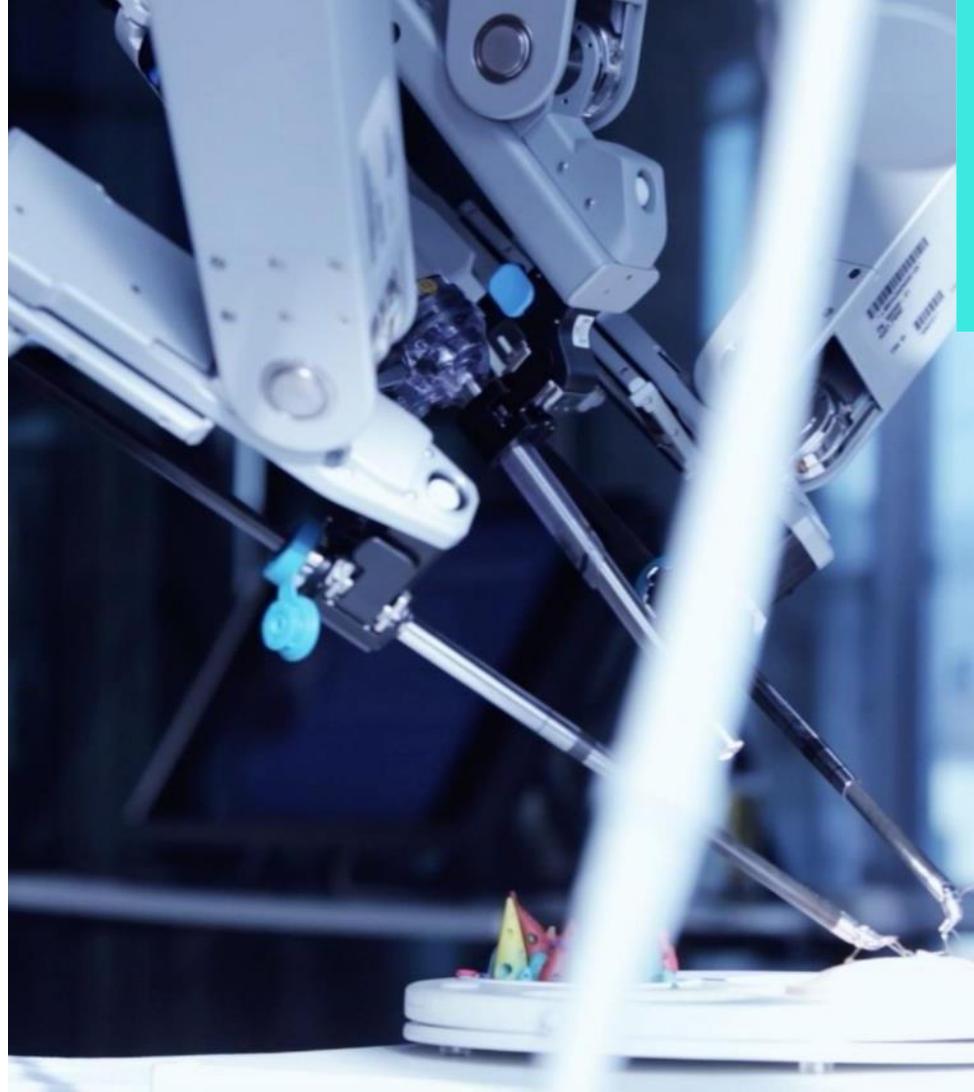
BU Electronics Solutions



BU Micro- electronics



LEITERPLATTEN

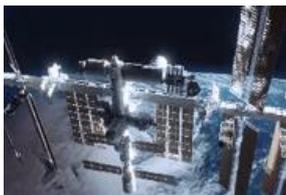


FÜHRENDER GLOBAL PLAYER MIT BREITER AUFSTELLUNG IM HIGH-END



Consumer and Computing

- Smartphones
- Wearables
- Datacenter



Industrial

- Telekominfrastruktur
- Satelliten
- M2X



Automotive

- Infotainment
- ADAS
- V2X



Medical

- Hörgeräte
- Bionics

Shanghai | China



Chongqing II | China



Nanjangud | Indien



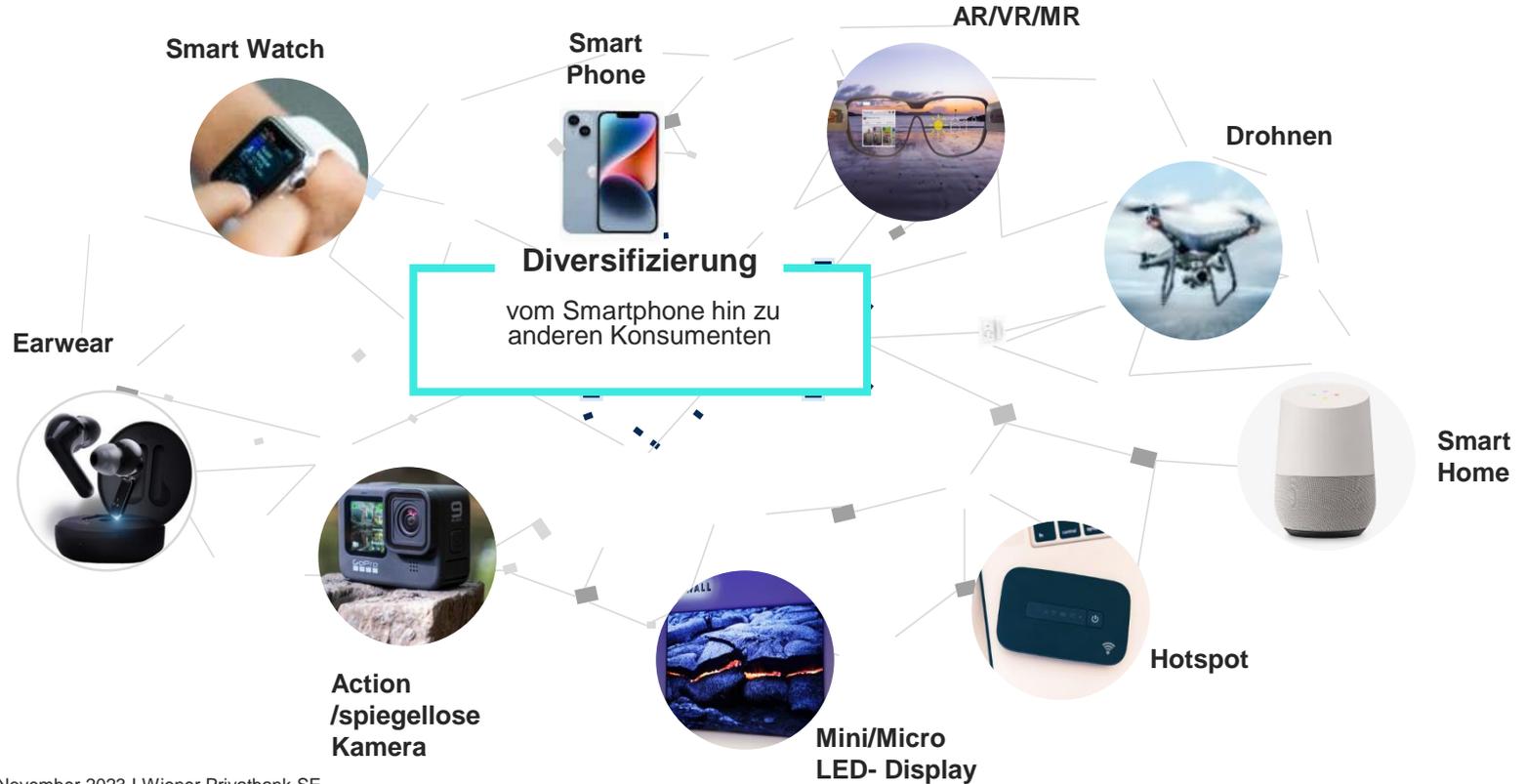
Fehring | Österreich



Ansan | Korea



DIVERSIFIZIERUNG IN UNTERHALTUNGSELEKTRONIK



SERVER ALS WACHSTUMSTREIBER AUCH FÜR PCB



Speicher



Beschleunigerkarte



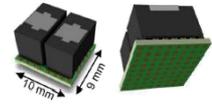
Optische Übertragung



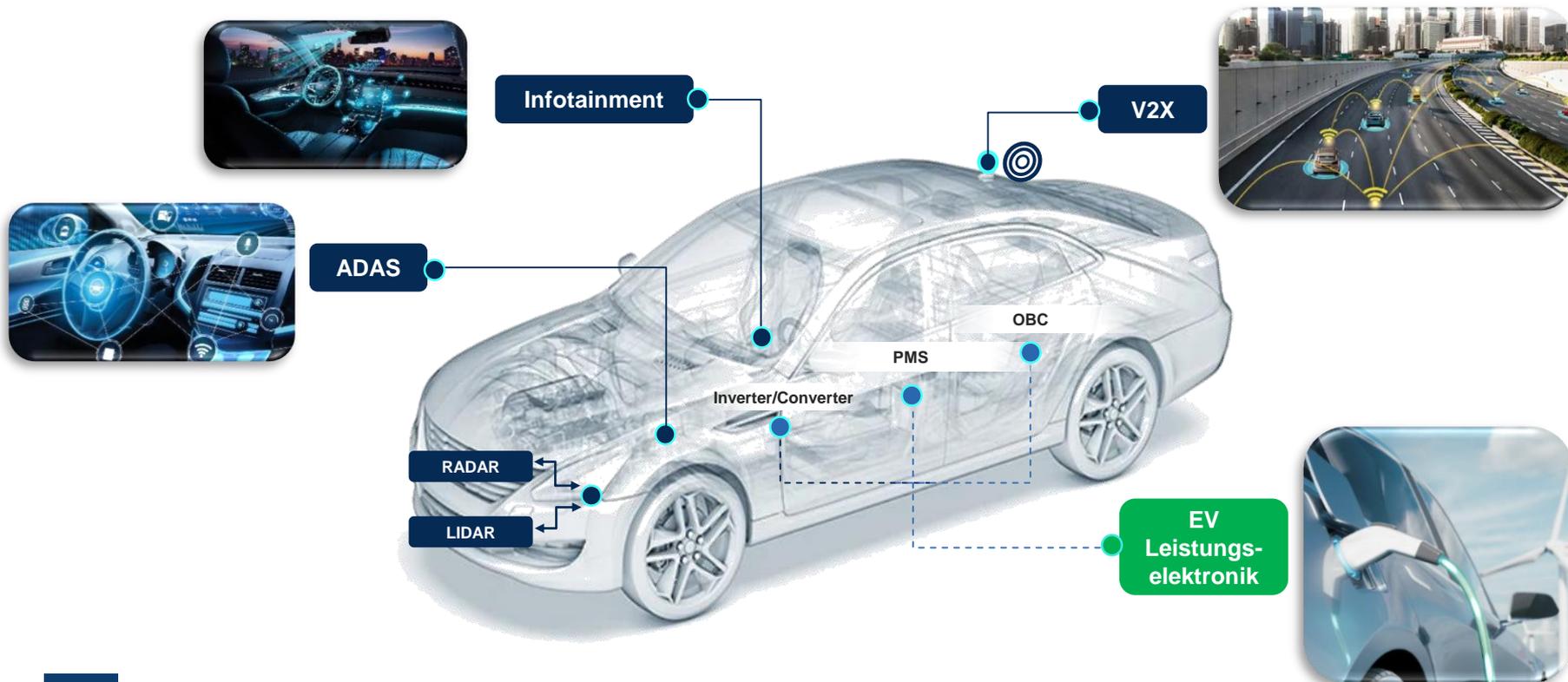
Datenverarbeitungskarte



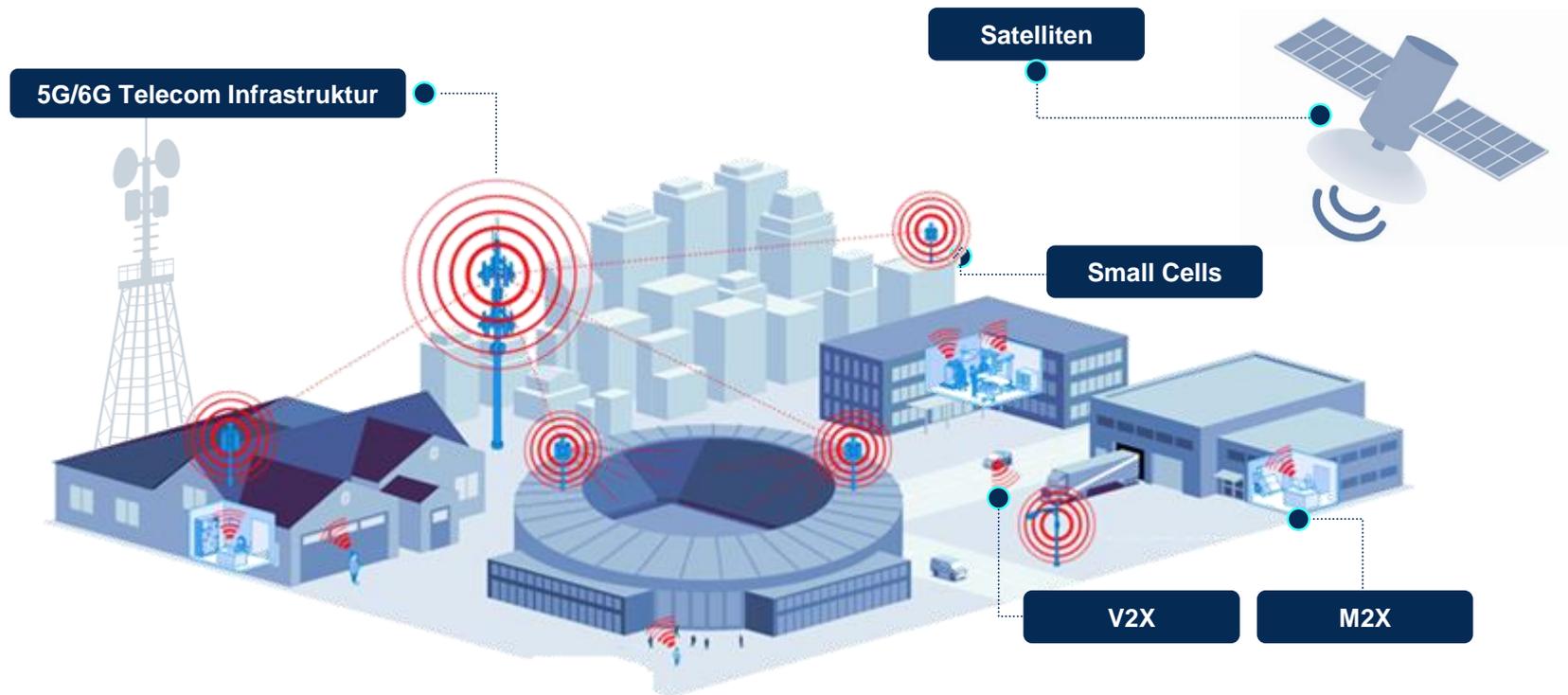
Stromversorgung



ZAHLREICHE ANWENDUNGEN IN AUTOMOTIVE

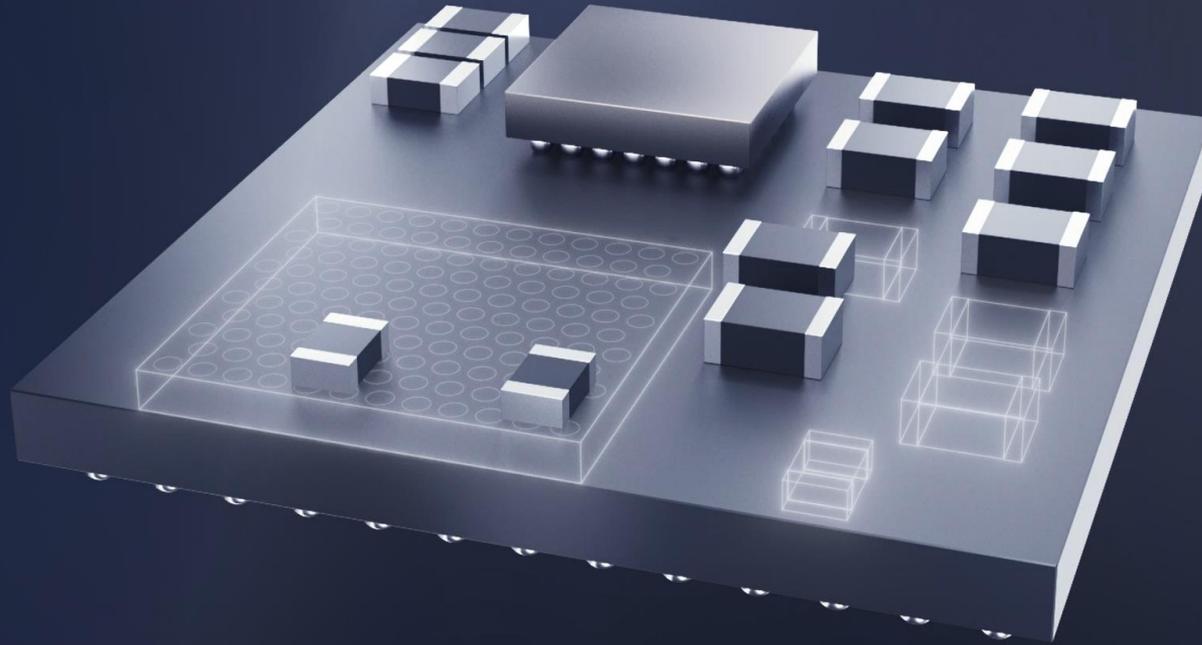


INFRASTRUKTUR TREND ZU HIGH-END



EMBEDDING: MEHR LEISTUNG BEI WENIGER PLATZ

Durch Embedding können Komponenten im Inneren der Leiterplatte die Verpackungsgröße deutlich reduzieren



EMBEDDING: MARKTPENETRATION LÄUFT

Märkte

Satelliten

Datenzentren

Stromversorgung

Elektroautos

Wichtige Player



Highlights

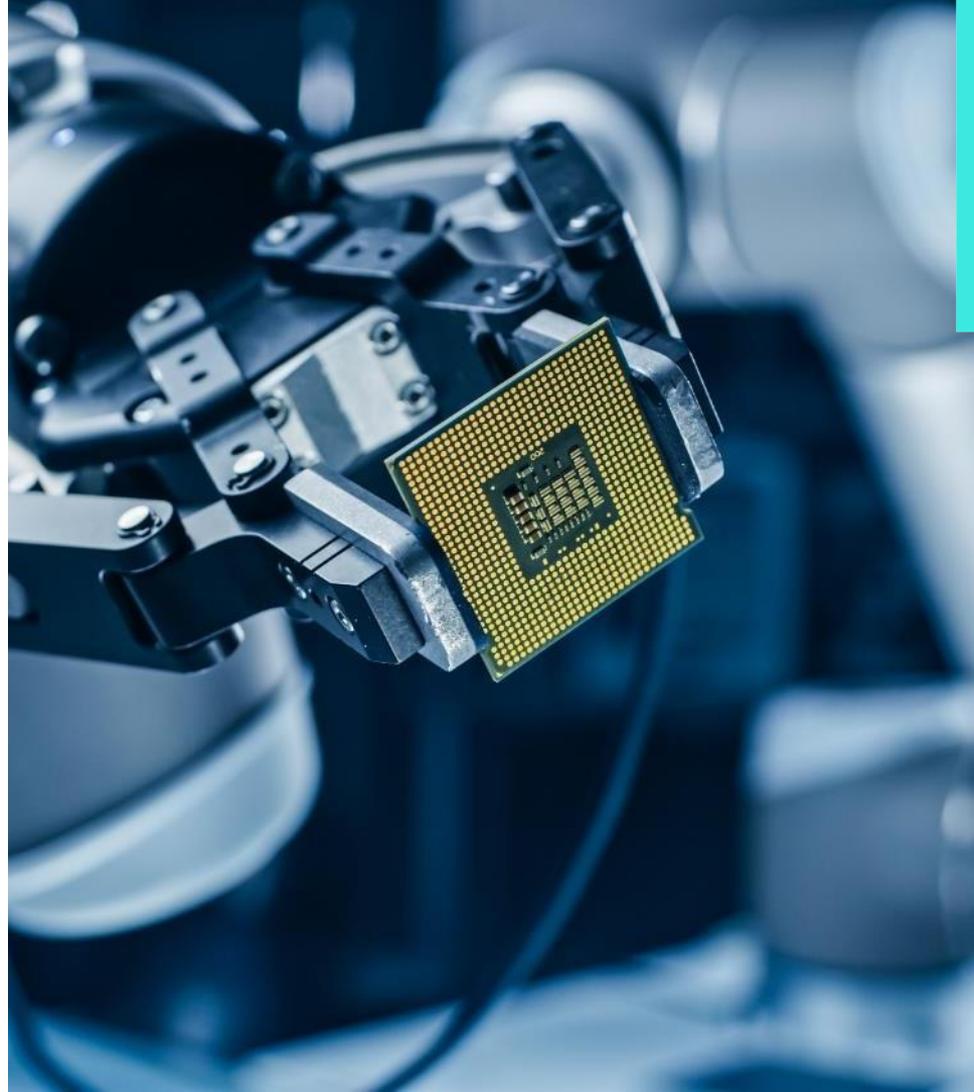
20+ Jahre Erfahrung

Zahlreiche F&E-Kooperationen

200+ Patente

Signifikante Co-Finanzierung
für Leistungshalbleiter

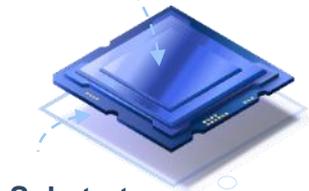
IC-SUBSTRATE



COMPUTING

Bisherige Architektur

Einzelner Chip

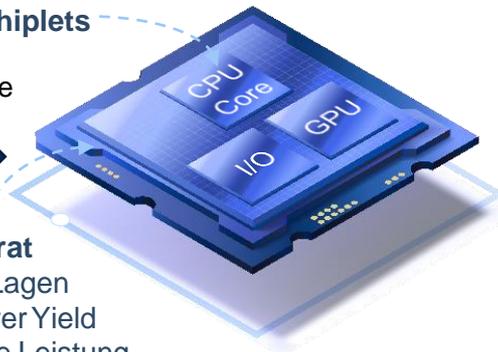


Substrat

Künftige Architektur

Chipllets

Heterogene
Integration



Substrat

- ✓ Mehr Lagen
- ✓ Geringerer Yield
- ✓ Verbesserte Leistung

Von der 2 nm node Technologie erwartet man sich **45 % höhere Rechenleistung** bzw. eine **Reduktion der verbrauchten Energie pro Rechenoperation von 75 %!**

(IBM Pressemitteilung: IBM Unveils World's First 2 Nanometer Chip Technology, Opening a New Frontier for Semiconductors, Albany NY, 6. Mai 2021)



AT&S FORSCHT AN NEUEN SUBSTRAT- UND VERPACKUNGSTECHNOLOGIEN, WIE DIESE PROZESSOREN UNSERE NETZWERKE NOCH SCHNELLER UND ENERGIEEFFIZIENTER GEMACHT WERDEN KÖNNEN.

KUNDEN- UND APPLIKATIONS-DIVERSIFIZIERUNG

Applikationen im Fokus und potenzielle Kunden



Kundendiversifizierung

Bestandskunden

Kunde A

Neue Kunden GJ 22/23

Kunde B

Kunde D

Kunde C

Kunde E

Anwendungsdiversifizierung

Voraussichtlich GJ 26/27

Server/Cloud-Computing



Networking/5G



HPC/AI



Client Computing



PRODUKTIONSNETZWERK FÜR IC-SUBSTRATE

LEOBEN-HINTERBERG

- Forschungs- und Produktionszentrums für Packaging und IC-Substrate
- Start Serienproduktion in 2024



CHONGQING I & III

- Großes Produktions-Know-how seit 2016 in CHQ I
- Kapazitätserweiterung durch CHQ III



KULIM

- Starke Kapazitätsausweitung
- Start Serienproduktion in 2024

LEOBEN HTB3 – PROJEKTFORTSCHRITT

Meilensteine im 2. Quartal

- 66 der 69 wichtigsten Maschinen bereits eingebracht
- Onboarding von 240 neuen Mitarbeitern, 28 Nationalitäten



Zahlen & Fakten

- **High-End-Produktion**
für IC-Substrate & Packaging-Technologien
- **Bruttogeschossfläche:** 39.000 m²
auf 3 Ebenen
- **Reinraum:** 11.000 m² ISO 5-8
(100* – 100.000)
- **F&E-Bereich:** 2.300 m²

Baustart: Februar 2022

Erste Maschineninstallation: April 2023

Produktionsstart: 2024

*3,531 <0,5µm Partikel je m³

BAUEN MIT HÖCHSTEM TEMPO



**Werk HTB3
2022**



**Werk HTB3
2023**



Reinraumausstattung

KULIM WERK 1 (K1) – PROJEKTFORTSCHRITT

Meilensteine im 2. Quartal

- **100% der Maschinen** eingebracht & angeschlossen
- **40% bereit für Prozessqualifizierung**
- **Zertifizierung des Werks** läuft und vollständig im Einklang mit Plan



Zahlen & Fakten

- **High-End-Fertigung** von IC-Substraten
- **Bruttogeschoßfläche:** 255.000 m²
- **Produktionsbereich/Reinraum:** 111.200 m²
ISO 5-7 (100* – 100.000)

Baustart: November 2021

Erste Maschineninstallation: Februar 2023

Bezug Bürogebäude: Januar/Februar 2024

Produktionsstart: 2024

Eröffnungsfeier: Januar 2024

*3,531 <0,5µm Partikel je m³

BAUEN MIT HÖCHSTEM TEMPO



**Werk Kulim
2022**

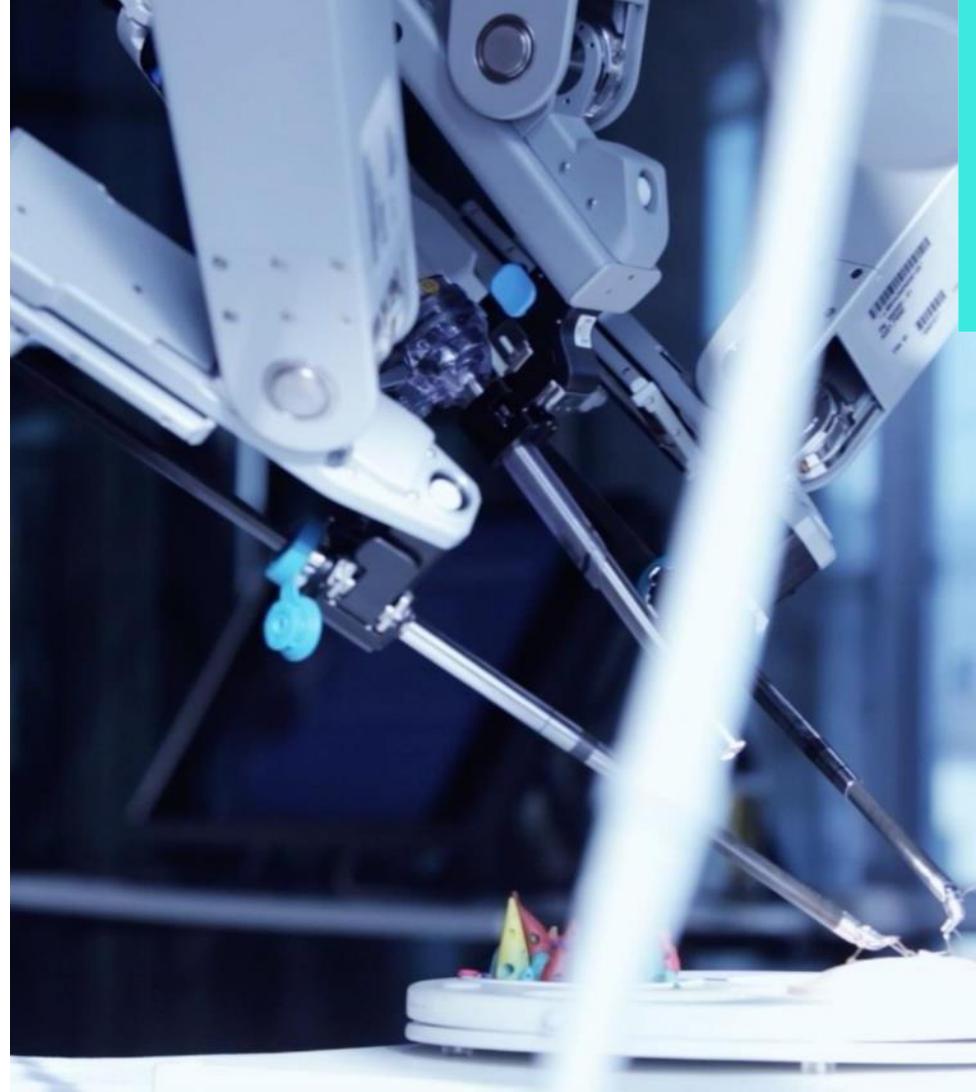


**Werk Kulim
2023**



Reinraumausstattung

FINANZEN & AUSBLICK



WESENTLICHE ENTWICKLUNGEN IM 1. HJ 2023/24

**Starkes
Quartal in
heraus-
forderndem
Umfeld**

- Grundlegend verändertes wirtschaftliches Umfeld gegenüber H1 2022/23
- Deutliche Erholung des EBITDA vom Tiefpunkt in Q4
 - Kostenoptimierungsprogramme mit signifikanten Auswirkungen
 - Zusätzlicher Rückenwind durch günstigen Produktmix und saisonale sowie einmalige Effekte
- Ausblick 2023/24 bestätigt
 - Herausforderndes Marktumfeld mit hoher Volatilität, geringer Visibilität und anhaltendem Preisdruck auch in H2 erwartet
 - Ergebnis weiterhin durch Effizienzprogramme gestützt
- Mittelfristiger Ausblick 2026/27 bestätigt

ERGEBNIS IM 1. HALBJAHR 2023/24

Umsatz

814 Mio. €

- Umsatz¹ verringerte sich um 24 %
- Electronics Solutions: -25 %
- Microelectronics: -22 %

EBITDA

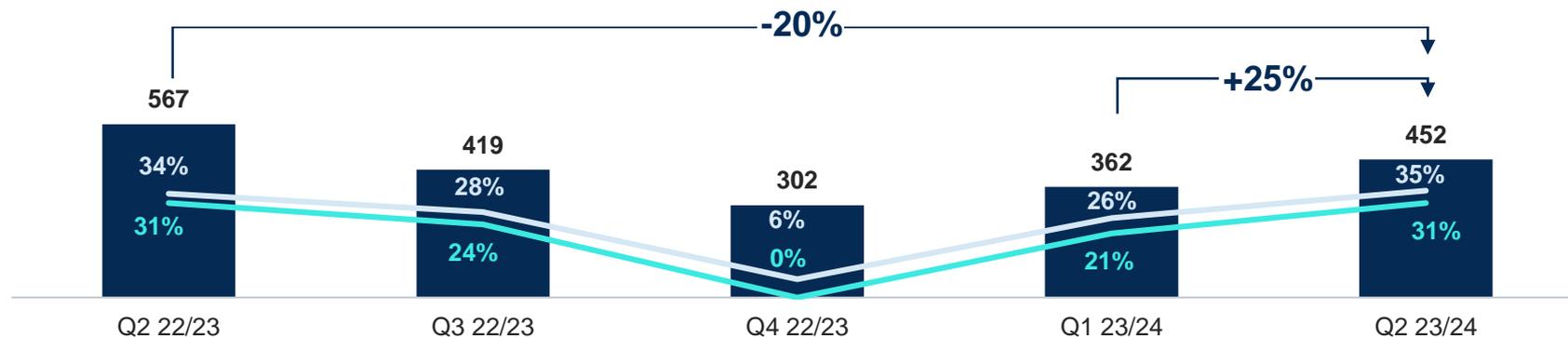
217 Mio. €

- EBITDA¹ verringerte sich um 31 %
- EBITDA-Marge: -2,9 PP → 26,6 %
- Bereinigte EBITDA-Marge: -0,7 PP → 30,6 %

Nettogewinn

49 Mio. €

- Nettogewinn verringerte sich um 78 %



AT&S REAGIERT AUF MARKTUMFELD

Kostenoptimierungs- und Effizienzsteigerungsprogramme



Erreichte Einsparungen

440 Mio. € gleichmäßig auf 8 Quartale verteilt

Operative Ausgaben

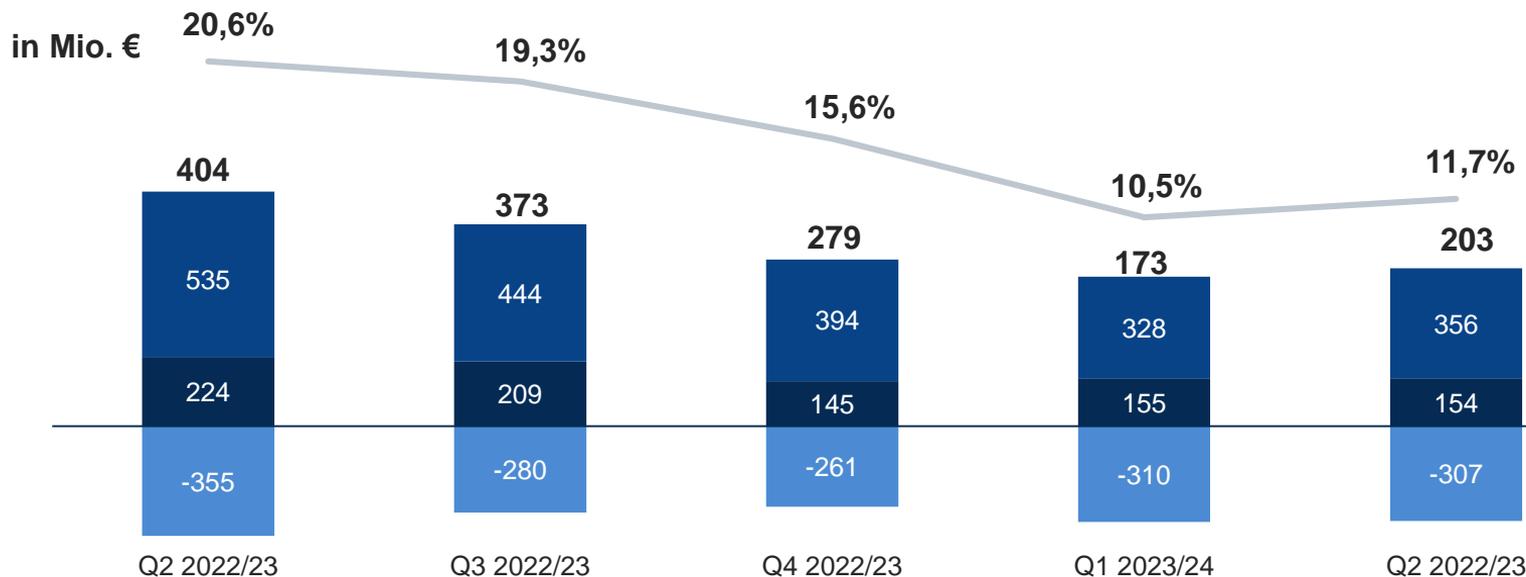
- Geplante Einsparungen von insgesamt 440 Mio. € für GJ 23/24 und 24/25
- Kombination von nachhaltigen (Effizienzsteigerung) und nicht-nachhaltigen Einsparungen (Kostensenkungen angepasst an die Marktnachfrage)

Investitionen

- Investitionsvolumen für GJ 23/24 und GJ 24/25 gegenüber ursprünglicher Planung um insgesamt 450 Mio. € reduziert und an Marktnachfrage angepasst

FOKUS AUF WORKING CAPITAL MANAGEMENT

Working Capital und Relation zum Umsatz



■ WC Forderung¹
■ Vorräte
 ■ WC Verbindlichkeiten²
— Net Working Capital zu Umsätzen der letzten 12 Monate

¹ Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Forderungen und vertragliche Vermögenswerte
² Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten sowie kurzfristige Rückstellungen, ohne Verbindlichkeiten aus Investitionen

AUSBLICK LAUFENDES GESCHÄFTSJAHR

GJ 2023/24

Umsatz rund 1,7–1,9 Mrd. €

Profitabilität

- Bereinigte EBITDA-Marge von 25–29%
- Anlaufeffekte der Projekte in Kulim und Leoben in Höhe von rund 100 Mio. €

Investitionen Nettoinvestitionen von bis zu 1,1 Mrd. €

MITTELFRISTIGER AUSBLICK

GJ 2026/27

Wachstum	Umsatz von rund 3,5 Mrd. € (CAGR +18 %)
Profitabilität	<ul style="list-style-type: none">▪ EBITDA-Marge von 27–32 %▪ ROCE von >12 % mit Anlauf der Fertigung
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none">▪ Nettoverschuldung/EBITDA: <3 (kann temporär überschritten werden)▪ Eigenkapitalquote: >30% (kann temporär unterschritten werden)

STÄRKEN & CHANCEN

WAS UNS JETZT STARK MACHT

1
Führender Hersteller von
High-End-Technologien

2
Diversifiziertes Kunden-
portfolio über breite
Industriesegmente

3
Europäisches Unternehmen
mit skalierbarer, globaler
Produktionspräsenz

4
Hohe Standards im
Bereich ESG und
Talentemanagement

5
Profitieren von
den Megatrends
Digitalisierung und
Elektrifizierung

6
Erfolgsbilanz als
Grundlage für
zukünftiges Wachstum

WAS WIR IN
ZUKUNFT
ANSTREBEN

**+ mittel-
fristig**
Durch profitables Wachstum
erreichen wir eine neue Ebene

**+ mittel-
fristig**
Top 3 Player
im High-End-
IC-Substrate-Markt

**+ lang-
fristig**
Gut etablierter
Anbieter fortschrittlicher
Packaging-Lösungen



VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT

DISCLAIMER

This presentation is provided by AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft, having its headquarter at Fabriksgasse 13, 8700 Leoben, Austria ("AT&S"), and the contents are proprietary to AT&S and for information only.

AT&S does not provide any representations or warranties with regard to this presentation or for the correctness and completeness of the statements contained therein, and no reliance may be placed for any purpose whatsoever on the information contained in this presentation, which has not been independently verified. You are expressly cautioned not to place undue reliance on this information.

This presentation may contain forward-looking statements which were made on the basis of the information available at the time of preparation and on management's expectations and assumptions. However, such statements are by their very nature subject to known and unknown risks and uncertainties. As a result, actual developments, results, performance or events may vary significantly from the statements contained explicitly or implicitly herein.

Neither AT&S, nor any affiliated company, or any of their directors, officers, employees, advisors or agents accept any responsibility or liability (for negligence or otherwise) for any loss whatsoever out of the use of or otherwise in connection with this presentation. AT&S undertakes no obligation to update or revise any forward-looking statements, whether as a result of changed assumptions or expectations, new information or future events.

This presentation does not constitute a recommendation, an offer or invitation, or solicitation of an offer, to subscribe for or purchase any securities, and neither this presentation nor anything contained herein shall form the basis of any contract or commitment whatsoever. This presentation does not constitute any financial analysis or financial research and may not be construed to be or form part of a prospectus. This presentation is not directed at, or intended for distribution to or use by, any person or entity that is a citizen or resident or located in any locality, state, country or other jurisdiction where such distribution, publication, availability or use would be contrary to law or regulation or which would require any registration or licensing within such jurisdiction.